

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字〔2017〕2005号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过130,505,709股。根据询价情况，本公司与主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向6名特定对象非公开发行普通股(A股)64,893,614股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.28元，共募集资金总额为731,999,965.92元。扣除承销费、保荐费25,440,000.00元(其中进项税额1,440,000.00元)后的募集资金为706,559,965.92元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2018年1月3日汇入本公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为19033101040020262人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用2,405,660.37元后，本公司本次募集资金净额705,594,305.55元。上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕1号)。

(二) 募集资金使用计划

1. 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资金额	
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	
其中：MEMS传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经技备案(2017)5号、6号
MEMS传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	金堂县经济科技和信息化局金经信技改备案〔2017〕1号

MEMS 传感器测试能力 提升项目	19,991.00	19,991.00	杭州市滨江区发展改革和经济局 滨发改体改(2017)003号
合 计	80,253.00	80,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于MEMS传感器芯片制造扩产项目、MEMS传感器封装项目和MEMS传感器测试能力提升项目，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，MEMS传感器芯片制造扩产项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称士兰集成公司)、MEMS传感器封装项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称成都士兰公司)，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

(1) 根据公司2018年1月23日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	70,559.43
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	30,568.43
MEMS 传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	20,000.00
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00
合 计	80,253.00	80,000.00	70,559.43

(2) 根据公司2019年11月8日第七届董事会第五次会议和2019年11月25日2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，基于产线升级、进一步提高募集资金使用效率等原因，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原募投项目的建设期、投资金额等进行调整，同时增加8吋芯片生产线二期项目和特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

原募投项目	总投资额	变更后募投项目	调整后募集资金投入金额	建设期
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43	一、年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	30,559.43	由 2 年调整至 7 年
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	30,568.43	其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	10,568.43	
MEMS 传感器封装项目	20,000.00	MEMS 传感器封装项目	10,000.00	
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	MEMS 传感器测试能力提升项目	9,991.00	
		二、8 吋芯片生产线二期项目	30,000.00	5 年
		三、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	3 年
合 计	70,559.43		70,559.43	

其中，8 吋芯片生产线二期项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司）、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为本公司孙公司成都集佳科技有限公司（以下简称集佳科技公司）。

（三）募集资金使用和结余情况

本公司、士兰集成公司、成都士兰公司及士兰集昕公司 2019 年度实际使用募集资金 2,856.98 万元、使用募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 817.73 万元；累计已使用募集资金 18,065.80 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 931.85 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司、士兰集成公司、成都士兰公司及士兰集昕公司募集资金余额为 31,425.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 1 月 23 日与东方花旗证券有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，本公司分

别和士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司于 2018 年 2 月、2018 年 2 月、2019 年 12 月与东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州市东新支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262	募集资金专户	3,475.02
士兰集成公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000826	募集资金专户	5,800.36
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331066080018800024087	募集资金专户	896.74
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331066080608500008311	通知存款	2,000.00
士兰集昕公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040025451	募集资金专户	19,253.36
合计				31,425.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2019 年 1 月 7 日本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意本公司使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该笔资金已于 2019 年 10 月 17 日全部提前归还至募集资金专户。

经 2019 年 4 月 11 日本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意本公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

经 2019 年 10 月 23 日本公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意本公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中 10,000 万元已于 2020 年 3 月 26 日提前归还至募集资金专户。

(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目变更情况详见本专项报告一（二）2（2）之说明
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

杭州士兰微电子股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				70,559.43		本年度投入募集资金总额				2,856.98		
变更用途的募集资金总额				40,000.00		已累计投入募集资金总额				18,065.80		
变更用途的募集资金总额比例				56.69%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	截至期末 承诺投入 金额 (2)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (3)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (4) = (3) - (2)	截至期末投 入进度 (%) (5) = (3) / (1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	是	80,000.00	30,559.43	未作分期承诺	2,108.35	17,317.17		56.67	2024 年 12 月	2019 年该项目实现销售收入 6,481.37 万元，实现销售毛利 1,390.36 万元，实现净利润-224.11 万元		否
8 吋芯片生产线二期项目	是		30,000.00	未作分期承诺	748.63	748.63		2.50	2024 年 12 月	该项目处于建设期		否
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	是		10,000.00	未作分期承诺					2022 年 12 月	该项目处于建设期		否
合 计	—	80,000.00	70,559.43		2,856.98	18,065.80			—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	年产能 8.9 亿 只 MEMS 传感器扩产项目建设期由 2 年调整至 7 年，详见本专项报告一（二）2（2）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（一）2
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投入金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
8 吋芯片生产线二期项目	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	30,000.00	未作分期承诺	748.63	748.63	2.50	2024 年 12 月	该项目处于建设期		否
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目		10,000.00	未作分期承诺				2022 年 12 月	该项目处于建设期		否
合 计	—	40,000.00		748.63	748.63	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本报告“一、募集资金基本情况”之（二）2（2）						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						